附圖 1：系爭專利相關圖式

1. 系爭專利第一圖為習知積體電路堆疊構造的剖視圖。

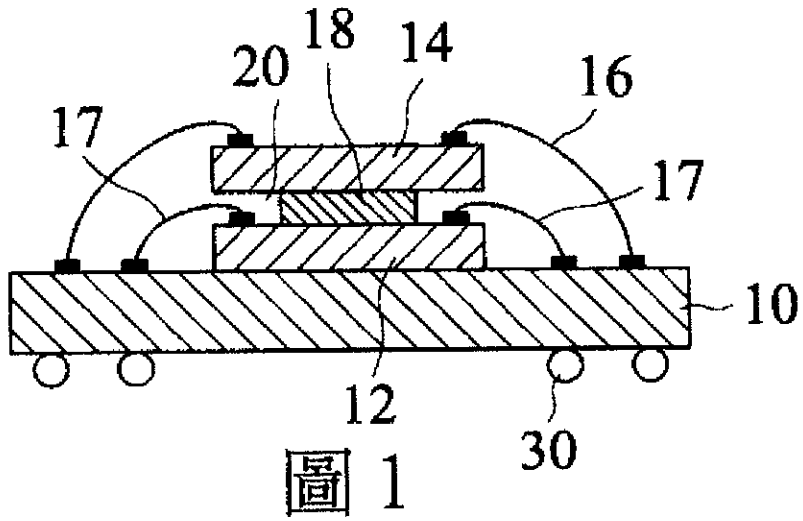
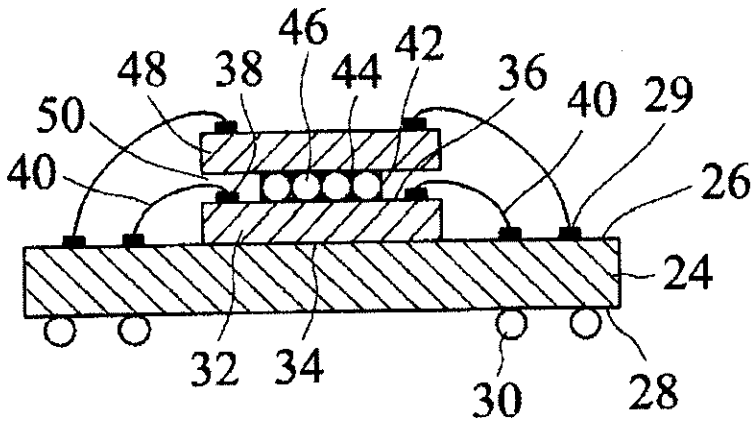


圖 1

基板 10　　下層積體電路 12　　上層積體電路 14

複數條導線 16、17　隔離層 18　間距 20

2. 系爭專利第二圖為積體電路堆疊構造的剖視圖。



基板 24　第一表面 26　第二表面 28　訊號輸入端 29

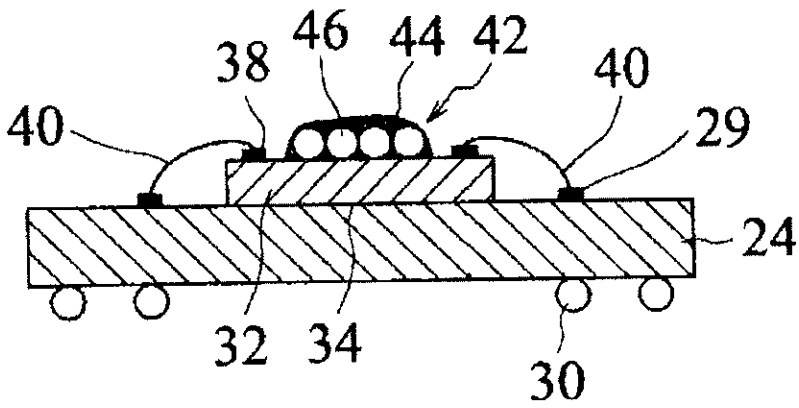
球柵陣列式之金屬球 30(Ball Grid Array)

下層積體電路 32　焊墊 38　導線 40

黏著層 42　黏著液 44　填充元件 46

下層積體電路 32 之第二表面 36

3. 系爭專利第三圖為積體電路堆疊構造示意圖



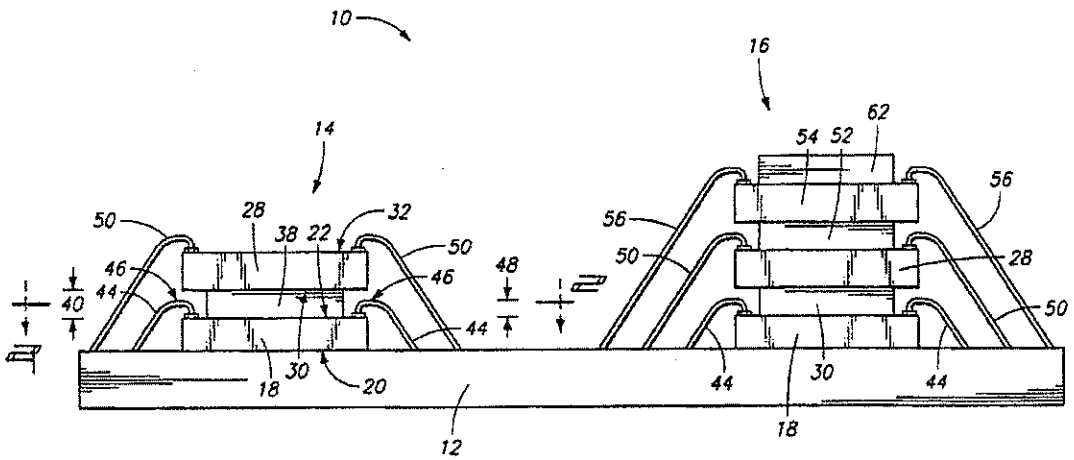
基板 24　第一表面 26　第二表面 28　訊號輸入端 29

球柵陣列式之金屬球 30(Ball Grid Array)　下層積體電路 32

焊墊 38　導線 40　黏著層 42　黏著液 44　填充元件 46

下層積體電路 32 之第二表面 36。

附圖 2：證據 1 之相關圖式



第一晶片 18　第二晶片 28　第一/第二黏著層 38

附圖 3：證據 2 之相關圖式

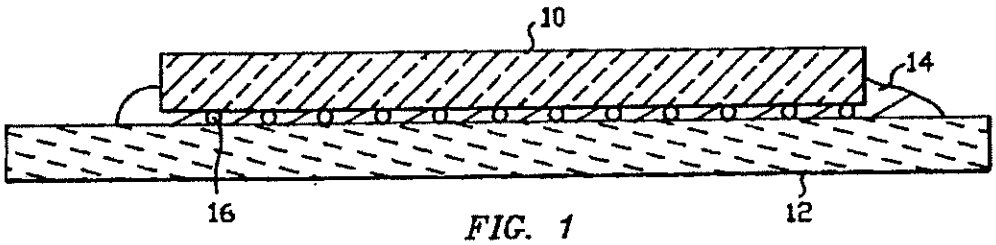


FIG. 1

基板 12　晶片 10　黏著接合材料 14　間隙元件 16

附圖 4：證據 3 之相關圖式

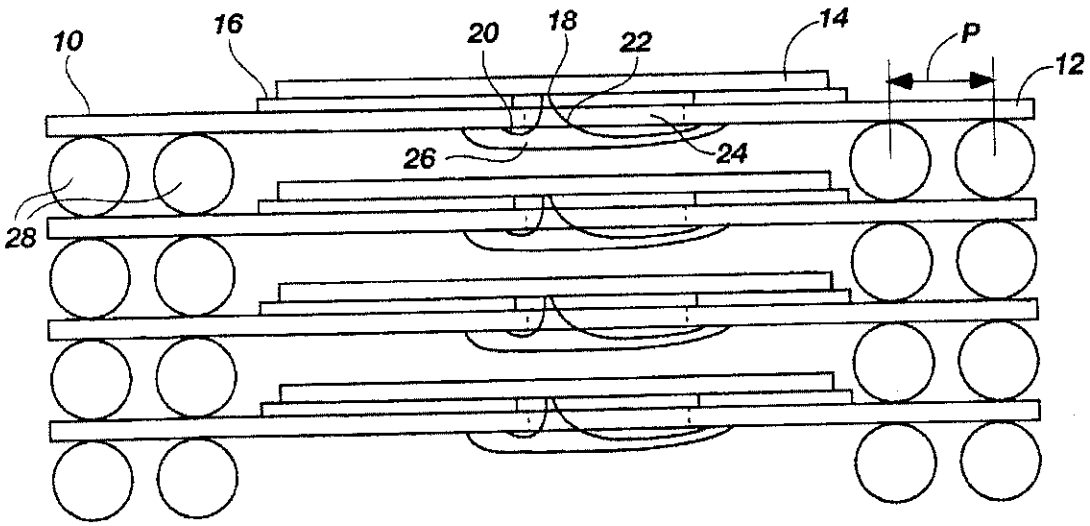


Fig. 1

附圖 5：證據 4 之相關圖式

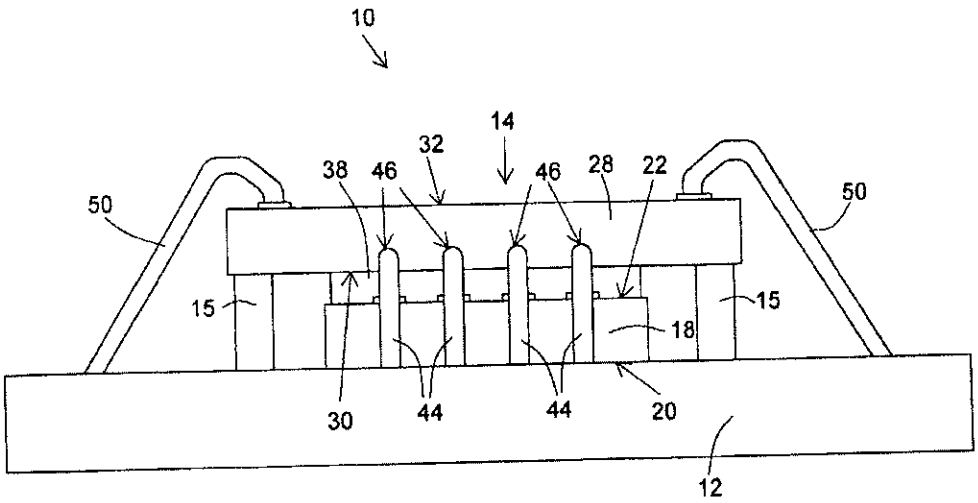


Fig. 1

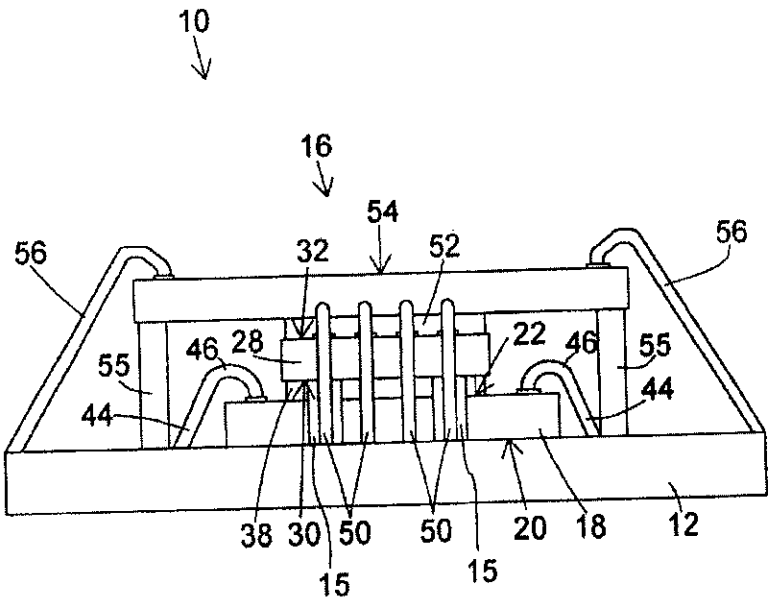


Fig. 4

基板 12　柱狀物 15　第二晶片 28　黏著接合層 38、52